

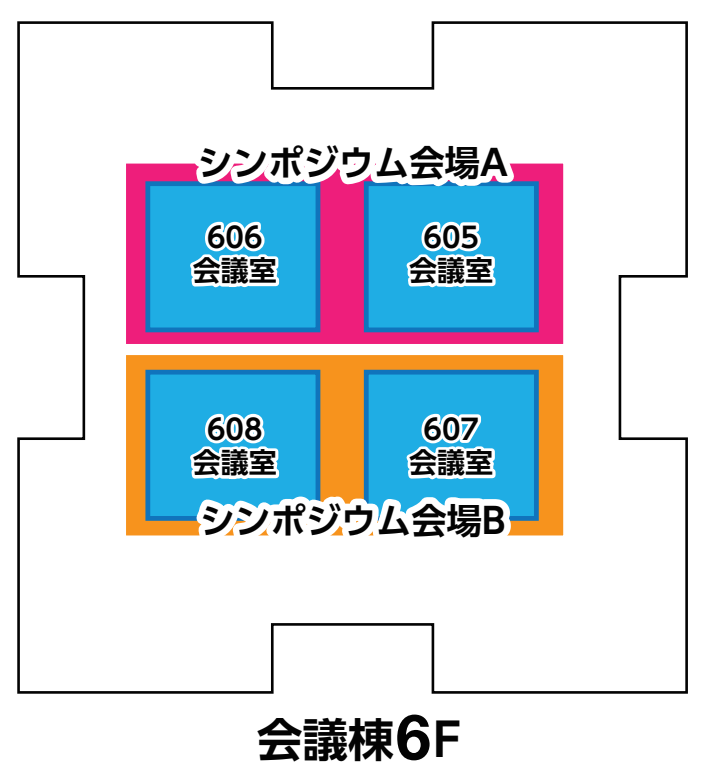




## 展示ホール内ゾーニング・セミナー会場案内図

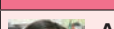
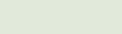


会議棟シンポジウム会場案内図




[電子機器トータルソリューション展](#)
[基調講演](#)
[要事前登録](#)
[セミナー会場A](#)

[JISSO PROTEC 特別講演](#)
[無料](#)
[要事前登録](#)
[セミナー会場G](#)

| 6月4日(水)        |                                                                                                                                                                                              | 6月5日(木)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 6月6日(金)        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:30<br>11:20 | <br>AIと半導体が世界経済を引っ張る<br>主役の時代がやって来た!<br>～後工程の重要性、チップレット、<br>パッケージ基盤の高度化に注目～<br><br>泉谷 渉<br>(株)産業タイムズ社 取締役 会長 | <br>日本の半導体戦略の現状と今後<br><br>清水 英路<br>経済産業省 商務情報政策局 情報産業課<br>デバイス・半導体戦略室 室長                                                              | <br>AFEELAにおけるモビリティの<br>新たな価値基準の創造<br><br>川西 泉<br>ソニー・ホンダモビリティ(株)<br>代表取締役社長 兼 COO | 10:30<br>11:20 | <br>スマートフォン・周辺機器、AIサーバーの<br>業界見通し<br><br>中根 康夫<br>みずほ証券株式会社 エクティ調査部<br>グローバル・ヘッド、オブ・テクノロジー・リサーチ<br>シニアアナリスト | <br>サイバートラック(テスラ) 分解から読み解く<br>電動車用パワー半導体実装技術トレンドと<br>将来動向<br><br>山本 真義<br>名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 | <br>JEITA2024 年度版実装技術ロードマップ<br>[注目される市場と電子機器群]<br><br>西村 隆<br>一般社団法人電子情報技術産業協会<br>Jisso 技術ロードマップ専門委員会 委員長<br>三菱電機株式会社 先端技術総合研究所<br>先進パワーデバイス技術部 主席研究員 |
| 11:30<br>12:20 | <br>未来を創る最先端半導体パッケージング技術<br><br>荒木 康<br>新光電気工業(株) 開発統括部長<br>上席執行役員 開発統括部長                                    | <br>IBM地域DXセンターが掲げる産官学共創と<br>人材育成<br>～チップレット・AI半導体・工場自動化<br>などへの展開～<br><br>山之口 裕一<br>日本アイ・ビー・エム(株) 製造・流通・公益・<br>統括サービス事業部 事業部長・常務執行役員 | <br>脳が語る未来:<br>柔軟・伸縮性エレクトロニクスが拓く<br>新たな生体センシング<br><br>関谷 毅<br>大阪大学 産業科学研究所 教授      |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |

[JIEP 最先端実装技術シンポジウム](#)
[有料](#)
[事前登録](#)
[最先端実装技術シンポジウム](#)
[A会場・B会場](#)
[会議棟 6F](#)
[ダントツものづくりセミナー](#)
[無料](#)
[事前登録不要](#)
[セミナー会場C](#)
[主催者企画セミナー](#)

6月4日(水)

A会場 (会議棟 605・606)

4A-1 10:00-12:30

5G/6G向け高周波対応材料開発動向

座長：杉本 博文、高野 希

半導体/PKG2025年展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

4A1 10:00-10:50

Beyond5Gに向けた高速通信適用向け基板材料の技術開発動向

座長：杉本 博文、高野 希

半導体/PKG2025年展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

4A2 10:50-11:40

5G/6G向け低遅延通信適用向け基板材料の技術開発動向

座長：杉本 博文、高野 希

半導体/PKG2025年展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

4A3 11:40-12:30

5G/6Gに向けたBT/フレキシブル基板材料の技術開発動向

座長：杉本 博文、高野 希

半導体/PKG2025年展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

4A-2 13:30-16:00

光電融合技術の新潮流と最新動向

座長：中根 健夫、谷 元朗

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4A3 13:30-14:20

スーパーコンピュータのインターコネクト技術動向と光電コパッケージングの期待

座長：安島 豊一、富士雄

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4A4 14:20-15:10

800Gbps/1.6Tbps 実現に向けてのシステム開発動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4A5 15:10-16:00

光エレクトロニクス技術の最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-1 10:00-12:30

生成AIの最新動向、現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

4B1 10:00-10:50

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

4B2 10:50-11:40

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

4B3 11:40-12:30

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

4B-2 13:30-16:00

新/パワーモジュール3D実装の動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 13:30-14:20

WBG/パワーデバイスの3D実装と通信・エッジコンピューティングの動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 14:20-15:10

パワーモジュールの高熱化と技術開発動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 15:10-16:00

パワー半導体 GaN/デバイスの社会実装を加速するための取り組み

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-1 10:00-12:30

CHIPLETの最新動向、現状と課題 (Playerの役割)

座長：西田 秀行、森山 孝幸

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 10:00-10:50

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 10:50-11:40

Customization & Energy-efficiency Improvement with Advanced Packaging for AI Infra

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 11:40-12:30

AI/ML Hardwareの現状と課題

座長：西田 秀行、森山 孝幸

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-2 13:30-16:00

CHIPLETの最新動向、現状と課題 (Process/Architecture)

座長：西田 秀行、森山 孝幸

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 13:30-14:20

CMP/研磨最新動向、開発の歴史、必要性/必然性、言えない話(?)

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 14:20-15:10

モールドリングの改良と先端パッケージにおけるモールドリング技術

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 15:10-16:00

ハイブリッド接合の発展/学会の最新動向、課題と期待について

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

半導体とAI開発最新動向

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月5日(木)

5B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月6日(金)

6C-1 10:00-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 10:00-10:50

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 10:50-11:40

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 11:40-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C-2 13:30-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 13:30-14:20

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 14:20-15:10

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 15:10-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月4日(水)

4B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月5日(木)

5B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月6日(金)

6C-1 10:00-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 10:00-10:50

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 10:50-11:40

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 11:40-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C-2 13:30-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 13:30-14:20

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 14:20-15:10

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 15:10-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月4日(水)

4B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月5日(木)

5B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月6日(金)

6C-1 10:00-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 10:00-10:50

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 10:50-11:40

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 11:40-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C-2 13:30-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 13:30-14:20

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 14:20-15:10

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 15:10-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月4日(水)

4B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

4B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月5日(木)

5B-1 10:00-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 10:00-10:50

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 10:50-11:40

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 11:40-12:30

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B-2 13:30-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B1 13:30-14:20

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B2 14:20-15:10

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

5B3 15:10-16:00

生産性向上へのつくりDX特別セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

トヨタ式現場管理と改善創出・成果セッション

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6月6日(金)

6C-1 10:00-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 10:00-10:50

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C2 10:50-11:40

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C3 11:40-12:30

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C-2 13:30-16:00

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

3D-MIDパビリオンセミナー

座長：土門 孝彰、池田 浩樹

6C1 13:30-14:20

3D

|                                         |  |          |                                              |  |              |
|-----------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------|--|--------------|
| JIEP アカデミックプラザ <small>無料</small> 事前登録不要 |  | セミナー会場 E | 出展者 (NPI) プレゼンテーション <small>無料</small> 事前登録不要 |  | セミナー会場 D・J・K |
|-----------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------|--|--------------|

| 6月4日(水)     |                                                                                    | 6月5日(木)                                                                     |                                                                                   | 6月8日(金)                                                                  |                                                                           | セミナー会場D (オープン)                                                  |  | セミナー会場J (オープン) |  | セミナー会場K (フーズド) |  |             |                                                               |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 13:00-13:20 | 人体通信技術を用いたドローン見守りシステムの検討<br>～パナソニックとウェアラブル電機との協力の伝達特性～<br>東京工芸大学                   | 樹脂バインダ中でのスズ系フッ物の環境現像の解析と導電性接着剤への応用<br>国立大学法人 群馬大学                           | 動力学シミュレーションを用いた多関節マイクロロボットの歩容解析<br>日本工業大学                                         | EMU対基盤設計の前駆検査<br>実測・解析・チェックツールを活用した効率的なアプローチ<br>株式会社エヌシーエー               | フレキシブル／プリントドレフトコンポーネント向け新規デバイス<br>作製の効率アップへ、研究開発用電子回路評価NOVA<br>テクノファクトリー  | 3D-MID&次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介<br>松澤 清彦 秋田県 技術本部 企画課 シニアパートナー     |  |                |  |                |  | 10:15-10:45 | 3D-MID&次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介<br>松澤 清彦 秋田県 技術本部 企画課 シニアパートナー   |  |
| 13:20-13:40 | 靴底電極とウェアラブル電磁場による人体通信における<br>靴底電極に対する伝送特性の比較<br>東京工芸大学                             | 真空成形中での動作バリエーション制御による<br>3次元導電性ペースト印刷形成の電気的接続性の向上<br>国立大学法人 群馬大学            | 3Dモデルを用いた大腸癌システム周術科の画像診断解析<br>日本大学理工学部 機械工学部                                      | ガラス・フィルム用レーザー加工システムの紹介<br>株式会社熱帯材料                                       | 次世代低圧RTリソニング層材料の紹介<br>三菱化学株式                                              | WFCが実現するこれまでにちかうMID工法<br>岡崎 肇希 関フタバ産業「カラーソリューション」 営業本部営業課 取締役   |  |                |  |                |  | 11:00-11:30 | 3D-MID&次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介<br>松澤 清彦 秋田県 技術本部 企画課 シニアパートナー   |  |
| 13:40-14:00 | ガラス基板上的ITO透明導電膜を利用した<br>カラーレーザの伝送特性の検討<br>東京工芸大学大学院                                | CNT分散導電ペーストにおける動的パーコレーションの<br>速度論的解析のための材料設計<br>国立大学法人 群馬大学                 | MEMS マイクロロボットに実装可能なシリコンデバイスの<br>開発<br>日本大学理工学研究科 機械電気工学専攻                         | BGAリワーク革命。WFCの省エネルギー化<br>道谷工業株式会社                                        | 「設備そのままで、稼働は未来へ」<br>超最先端の製造施設「ALUSAP」の社会実装と計画について<br>東洋精工ミッドウエスト          |                                                                 |  |                |  |                |  | 11:45-12:15 | WFCが実現するこれまでにちかうMID工法<br>岡崎 肇希 関フタバ産業「カラーソリューション」 営業本部営業課 取締役 |  |
| 14:00-14:20 | 給電線をガラス基板下に配置した透明広域電源ダイオード<br>アンプの検討<br>東京工芸大学                                     | 樹脂バインダ中での鉛サブリフローによる<br>導電ペースト形成制御と導電性ペーストへの応用<br>国立大学法人 群馬大学                | 微生物増殖における自動化を目的とした自律動作の解析<br>日本大学理工学部 機械電気工学専攻                                    | BGAリワーク革命。WFCの省エネルギー化<br>道谷工業株式会社                                        | 「設備そのままで、稼働は未来へ」<br>超最先端の製造施設「ALUSAP」の社会実装と計画について<br>東洋精工ミッドウエスト          |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 14:20-14:40 | マイクロシリコンを利用した体内外隔絶型における<br>生体内コアロ位置と横ばいに対する伝送特性<br>東京工芸大学                          | 可溶性樹脂バインダ配合設計による銀系導電性接着剤の<br>マイクロリアー糊状塗布と接続特性向上<br>群馬大学大学院理工学専攻             | カーネル主成分分析を適用したプリント基板加工環境破<br>りのカテゴリーデータマニピュレーションの観察<br>同志社大学大学院                   | 信頼性試験でも使える！ BGA実装基板検査の課題を解決する<br>JTAG（ワンステップ）システムのご紹介<br>アイノールシステムサポート㈱  | 高速高通信のカギを握る熱伝導率PTFE フィルム<br>FLEX™<br>ニチアセ                                 | ポイドレスTGV (Through Glass Via) フリンギング向け<br>電解銅めっきプロセス<br>上村工業株式会社 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 15:00-15:20 | カーボンナノチューブを用いた電波吸収材の遮断<br>周波数制御に関する検討<br>東北大学 大学院工学研究科                             | Au 薄膜転写等により製作したピラミッド型中空マイクロフ<br>ンを用いた 低温・低湿度環境<br>東北大学                      | Cuダイレクトリザーブアホール加工で絶縁層内ガラスクラ<br>ック形状形成によって与える影響と塗層一色法を用いた集<br>約化の最適化<br>長興材料工業株式会社 | 先導パッケージを実現する露光技術:<br>ダイレクト露光の活用<br>TDK㈱                                  | プリント配線およびその材料に求められるUL規格試験<br>とDAP (UL認証試験) サービスのご紹介<br>熱帯材料株式会社           |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 15:20-15:40 | もしも燃焼からなる樹脂接合シートの高周波減速<br>ノイズ抑制機能<br>東北大学 大学院工学研究科                                 | 低温抵抗接合を可能とする銅ナノ粒子系の構築<br>北海道大学 大学院工学研究科 米澤研究室                               | 左右ボールねじカウンタバランス調整機構を有する穴あけ<br>工作機械の加工効率および返戻性を考慮したシステム動作<br>の検討<br>長野県東工科大学       | ガラスA基板向け高スベクトルホールドフリッピング<br>試験網めぐり※添削(TOTALLY TECH GSシリーズ)<br>関谷システム株式会社 | 放熱材料の熱抵抗・熱伝導率評価サービスのご紹介<br>熱帯材料株式会社                                       |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 15:40-16:00 | LSIパッケージ内蔵用ハイブリッド磁心ワイヤリングデータの<br>試作と検証機能の開発<br>信州大学 工学部 電子情報システム工学科先端メディア系(情報) 研究室 | ウェアラブルな高精度分選計測センサによる<br>全身負荷分量測定装置の開発<br>公立茨城県立理科大学 機械電気工学科                 | 表面効果損失抑制のための負誘電率材料を用いた矩形溝<br>深さ調節の加工効率および返戻性を考慮したシステム動作<br>の検討<br>長野県東工科大学        | ENEPIGプロセス・めっきマスクング用ドライフィルム<br>[ALPHO® AUP1000シリーズ] のご紹介<br>長興材料工業株式会社   | 世界最高レベルのエングレービング技術によるレーザープロ<br>セス<br>ナラサキ産業株式会社                           |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 16:00-16:20 | 高空分解能磁気センサー用ハードウェアグループ<br>磁気ユークの基礎検討<br>信州大学 工学部 電子情報システム工学科先端メディア系(情報) 研究室        | 誘電型加温を用いた低温調理調理の試作とその加熱効果<br>の評価<br>東京理科大学大学院 創成理工学研究科 電気電子情報工学専攻           | 表面効果損失抑制のための負誘電率材料を用いた矩形溝<br>深さ調節の加工効率および返戻性を考慮したシステム動作<br>の検討<br>長野県東工科大学        | 水分の影響を受ける樹脂特性とその評価手法：湿潤度制<br>御下での解析<br>ティー・エイ・エス(株) / ジェイ・テック            | ラボからプロセスまで、薬液生産を自動化してみませんか？<br>SCREENからの新しい直接描画機のご紹介<br>株式会社スクリーン・パフォーマンス |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 16:20-16:40 | マウスへの磁界ばく露に対応した乳房脂肪等価<br>電磁ファントムの開発に向けた一検討<br>東京理科大学 創成理工学研究科 電気電子情報工学専攻           | マイクログラフアナライナーに対応した乳房脂肪等価<br>電磁ファントムの開発に向けた一検討<br>東京理科大学 創成理工学研究科 電気電子情報工学専攻 | 表面効果損失抑制のための負誘電率材料を用いた矩形溝<br>深さ調節の加工効率および返戻性を考慮したシステム動作<br>の検討<br>長野県東工科大学        | 電子材料分野で活躍するケルペル素系溶剤<br>日本テヘナ化学株式会社                                       | 表顕研最機ラインナップについて<br>石井幸太郎氏                                                 |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |
| 16:40-17:00 |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                           |                                                                 |  |                |  |                |  |             |                                                               |  |

6月4日(水)

6月5日(木)

6月8日(金)

6月9日(土)

無料

事前登録不要

セミナー会場B

6月4日(水)

6月5日(木)

6月6日(金)

6月7日(土)

13:00-14:00

プリント配線板全般の基礎「がりとんばんじゅくI」をもとに解説  
榎場 正男 株式会社バイオファス 代表取締役

14:15-15:15

プリント配線板設計の基礎「がりとんばんじゅくII」をもとに解説  
田中 弘文 TNK エンジンエンジニア 代表

15:30-16:30

フレキシブル配線板の基礎「がりとんばんじゅくVII」をもとに解説  
宮崎 博明 元MFインフォメーション 代表

6月6日(金)

12:30-13:30

実装の基礎「がりとんばんじゅくⅢ」をもとに解説  
榎場 正男 株式会社バイオファス 代表取締役

13:45-14:45

品質管理の基礎  
安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

Electronics Component & Unit Show

|                                                             |                       |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>PROTEC セミナー</b> <a href="#">無料</a> <a href="#">要事前登録</a> |                       | <b>セミナー会場 H</b>                     |                 |
| 15:30~15:50                                                 | デバイス材料の開発を支える材料分析の新展開 | 先導/バックグランド対応 微細加工ソリューション:<br>材料の微細化 | LTSpiceを電源設計に活用 |

| 6月4日（水）     |                                                                                                                                                        | 6月5日（木）                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 6月6日（金）     |                                                                                                     | 6月7日（土）                                              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 11:45-12:30 | SDGsに関係するディスプレイ技術と液体材料について<br><br>新井 貴<br>武蔵エンジニアリング マーケティング戦略部 係長                                                                                     | Autonomous Factoryの実現へ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～<br><br>パナソニック コネクティビリティ 回路形成プロセス事業部 PM/技術開発センター マネージャー 梶谷 勉<br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 営業企画部 マーケティング課 梶山 浩史 | 「ものづくりの現場はどう変わる？ オンデマンド AI と未来技術の最前線」<br>～FJII技術開発ロードマップ2030 Target ZEROより～<br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 営業企画部 マーケティング課 梶山 浩史                       | 16:10-16:30 | ガラス・フィルム用レーザー加工システム<br><br>清谷 工業 株式会社                                                               |                                                      |  |
| 12:55-13:40 | 実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025<br><br>若林 利晶<br>ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア                                                            | 実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025<br><br>若林 利晶<br>ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア                                                               | 実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025<br><br>若林 利晶<br>ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア                                                            | 10:30-10:50 | プラズマ処理を変える！ マイルドプラズマで～低消費電力と高品質の直接接合による次世代CCL～<br><br>エスディック株式会社<br>武蔵エンジニアリング 株式会社                 | SDGsに関係するディスプレイ技術と液体材料について                           |  |
| 14:05-14:50 | 進化し続ける FUJII Smart Factory<br>～3年の軌跡と未来への挑戦～<br><br>大山 茂人<br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 スマートファクトリー開発部 第4課 課長                                         | 【成功事例から学ぶ】 部品管理の効率化と秘訣を形勢にまよせんか<br><br>JUKI株式会社 生産ユニット ストレーンビンジ・システム・サービス部 部長 原田 可奈乃                                                                      | Autonomous Factoryの実現へ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～<br><br>パナソニック コネクティビリティ 回路形成プロセス事業部 PM/技術開発センター マネージャー 梶谷 勉<br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 PMプロジェクト 部長 梶山 浩史 | 11:50-11:30 | LDX 基板（環境型基板）のご提案-全世界のプリント基板での CO2排出量削減への貢献-<br><br>シャイ電子工業株式会社<br>エレクトロニクスジャパン株式会社                 | ラボからプロセスまで、薬液分析を自動化してみませんか？                          |  |
| 15:15-16:00 | Autonomous Factoryの実現へ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～<br><br>パナソニック コネクティビリティ 回路形成プロセス事業部 PM/技術開発センター マネージャー 梶谷 勉<br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 PMプロジェクト 部長 梶山 浩史 | サイクルナビゲーターで印刷パラメータを提示～Printing Navigator～<br><br>株式会社 FUJII ロボットソリューションズ 事業本部 PMプロジェクト 部長 梶山 浩史                                                           | ゼロエミッション達成へ貢献する、はんだ付け材料<br><br>株式会社 千住金属工業株式会社 研究開発部 瀬戸 研司 課長 上級研究員 梶谷 勉                                                                               | 13:30-13:50 | 最先端工機ロジックをを支える新材料ソリューション<br><br>旭化成株式会社<br>旭化成株式会社                                                  | 電子回路基板用リリム、ルーターの最新技術情報                               |  |
|             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 14:10-14:30 | 性能試験でも使える！ BGA 実装基板検査の課題を解決する JTAG/FPGAシステム・チャプタースとのご紹介<br><br>アンダーシステムサポート株式会社<br>東洋電子エレクトロニクス株式会社 | 「設備そのまま、配線は未来へ」～「実装型配置 AI」                           |  |
|             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 14:50-15:10 | 遠隔検、局所加熱に対応したHTRFプローベ化接着剤の開発<br><br>協立化学産業株式会社<br>株式会社 ジェイ・エス・エー                                    | 基板のクリーンにおける静電制御 ～スマートファクトリー1に対応した Teknek 社の基板クリーン技術～ |  |
|             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 15:30-15:50 | 炭化無し・基板分割はクリーンなレーザーカットの時代へ<br><br>株式会社 ジェイ・エス・エー                                                    |                                                      |  |

### デモンストレーション / 体験

#### ■脳波ゲーム体験

脳波ゲーム体験 ーあなただけの色を色で表現ー

1日4組体験コーナーにて（11:00、13:00、14:00、15:00）実施

脳波計と色覚照明を利用したゲーム体験 "Colors"

ハバ抜きと色引きを組み合わせて、色で表現した心像状態が見える体験ができます。

技術提供：  
脳アセス / Visionary Lab "Colors"  
大阪大学 脳科学研究室  
PGV 株式会社

#### ■村田製作所

安全なモノづくりは健康管理から

ー簡単に測定で心と身体の状態を知り、無理なく働くヒートンー

体験時間：10 - 15 分程度

技術提供：  
村田製作所  
（一社）スポーツ能力発見研究会

11:45-12:15 "在庫処分"から"在庫活用"へ！新しい在庫マネジメントの提案  
山口 麗美 コアスタッフ様 第3Business Unit SBU1 インサイト営業担当

11:45-12:15 "在庫処分"から"在庫活用"へ！新しい在庫マネジメントの提案  
山口 麗美 コアスタッフ様 第3Business Unit SBU1 インサイト営業担当